



裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

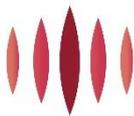
证券代码：688515

证券简称：裕太微

裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT_ZQSWB_20240513

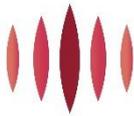
投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2023年度科创板芯片设计专场（二）集体业绩说明会）
参与人员单位名称及姓名	参加业绩说明会的广大投资者
日期时间	2024年5月13日（周一）15:00-17:00
地点	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：史清 董事会秘书：王文倩 财务总监：柴晓霞 独立董事：计小青
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>一、介绍环节</p> <p>首先就公司2023年年度及2024年一季度经营情况做简要说明。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、2023年，裕太微在高速通信芯片领域是否实现了关键技术或产品的市场突破？具体在哪些应用场景，如数据中心、云计算或5G基础设施中，裕太微的芯片解决方案得到了广泛应用？公司有没有推出新的高速以太网交换芯片或其他通信芯片，这些产品的技术优势是什么，如何帮助客户提升系统性能和降低功耗？此外，裕太微在提升国产芯片自主可控方面做出了哪些贡献，如何在国际竞争中增强自身的竞争力？</p> <p>答：公司致力于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。通过多年的自主</p>



创新和技术研发，公司掌握了 14 项与主营业务密切相关的核心技术，包括高性能 SerDes 设计技术、高性能 ADC 设计技术等，公司已形成网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片、车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载网关芯片、车载高速视频传输芯片七条产品线。其中网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片和车载以太网物理层芯片均已实现规模量产。公司产品覆盖数通、安防、消费、电信、工业、车载等多个领域，产品分为商规级、工规级、车规级等不同性能等级，以及百兆、千兆、2.5G 等不同传输速率和不同端口数量的产品组合，涵盖路由器、中继器、LED 显示屏、智能电视、无线终端、光伏、充电桩、快递柜、机顶盒、网络打印机、摄像头、矿业、电力系统、数据中心、工业控制、船舶、交换机、服务器、工业互联网、工业自动化、智能仪表、辅助驾驶、毫米波雷达、智能中控、激光雷达等多个应用场景，可满足不同终端客户各种场合的应用需求。以太网物理层芯片是一个复杂的数模混合芯片系统，公司各团队之间通过磨合和经验积累已形成了一套极具竞争力的产品研发流程体系，产品已被广泛地运用于国内知名客户产品之中，为芯片后续的技术提高和性能优化提供了坚实基础。对于网通市场，公司将通过自主可控不断拓宽现有客户市场以及挖掘新型应用市场，以实现国内市场业务规模的快速增长。在海外市场上，公司在海外成立子公司，通过与国际知名代理商合作丰富销售渠道，建设品牌价值，并快速拓展海外市场。在公司大研发战略的推动下，截止 2023 年年底，共计量产 47 款产品，半年时间增加了 17 款，取得了很大的进展。后续，公司将不断拓展相关产品领域，适应新的产品应用场景，在 5G-A/6G、车联网、高速铜线传输等各个新趋势下为新质生产力做更多贡献。

2、请问公司预计今年驱动销售额增长的第一和第二大细分业务领域是？

答：一方面，2023 年公司已形成网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片、车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载网关芯片、车载高速视频传输芯片七条产品线。截至 2023



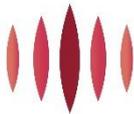
年末，网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片和车载以太网物理层芯片均已实现规模量产，共计 47 款产品，款式增长较为可观。另一方面，随着客户端去库存周期收尾，工规级产品将逐步复苏。

3、**董事长你好，请问 1) 今年一季度车载以太网芯片的销售情况对比去年 4 季度如何？有没有进入华为/赛力斯产品线？ 2) 今年 1 季度在工规级，商规级，车载等业务线的销售占总销售比例是多少？ 3) Serdes 芯片目前合作测试厂商是哪些？预计什么时候实现量产？谢谢**

答：尊敬的投资者，您好。随着半导体行业周期性收尾，公司新品逐步放量，各行业设备更新迭代的政策出台，以及行业应用领域的拓展使得公司 2024 年第一季度营业收入较上年同期增长。营业收入为 7,253.15 万元，同比增长 35.81%；产品销售量同比增加 41.01%，环比增加 28.60%；产品销售额同比增加 80.08%，环比增加 6.18%。具体业务线占比情况请关注后续的定期报告。公司车载 Serdes 系列芯片 YT7xxx，基于 MIPI Alliance 联盟制定的 MIPI APHY 协议，其通信速率覆盖 2~8Gpps。该系列芯片利用公司在车载以太网积累的车载芯片设计、量产及应用经验，在前期设计中充分考虑车规应用的各种严苛要求，具备极高可靠性及优异的 EMC 性能，满足车载摄像头 2M~8M 分辨率的主流应用需求，该产品预计将于 2025 年内推出。感谢您对公司的关注。

4、**公司之前 4000 万回购额度已经用完，目前股价仍处于回购区间的底部，是否有进一步回购的计划？**

答：公司已于 2024 年 5 月 7 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告》，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。后续如有进一步回购的计划，公司将会按相关规定及时履行信息披露义务。公司将



	<p>持续提升经营管理水平，不断提高公司盈利能力，积极回报各位投资者。</p> <p>5、史总：请介绍一下贵公司车载物理层芯片跟华为的竞争关系，以及优势和不足之处。谢谢</p> <p>答：公司目前已有七条产品线，其中车载产品线就占据了四条，足见公司对于车载领域的重视和对汽车未来发展给予的高度信心。目前公司已量产车载以太网物理层芯片，百兆产品已规模量产，千兆产品已提前量产出货，预计 2024 年相对于 2023 年车载领域将在营收端获得突破性进展。车载以太网交换机芯片相对于之前的预测时间将进一步提前，预计于 2025 年年初问世。车载高速视频传输芯片加速研发中，预计于 2025 年年底问世。车载网关芯片也在积极研发中，三年内将有所成。预计整个汽车产品的智能化大规模应用落地时间在 2027 年到 2028 年，后续公司在完成上述产品系列后，将组成完整的车内高速有线通信芯片系列销往各个 Tier&nbsp;One 或者 OEM 厂商，成为国内大陆地区车内高速有线通信芯片全覆盖的先行者。</p>
附件清单(如有)	无

